

平成30年10月26日

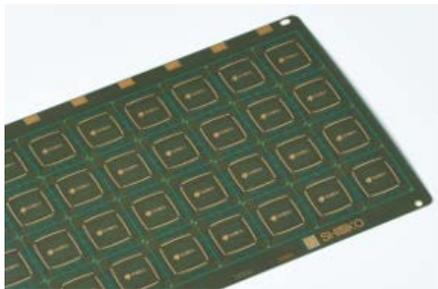
各 位

会社名 新光電気工業株式会社  
代表者名 代表取締役会長兼社長 豊木 則行  
コード番号 6967 東証第1部  
問合せ先 コーポレートコミュニケーション室長  
清野 貴博  
TEL (026) 283-1000 (代)

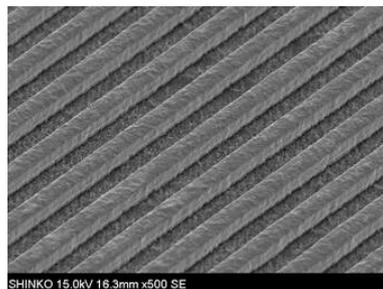
## 次世代プラスチックBGA基板の設備投資に関するお知らせ

当社は、今般、半導体メモリーの小型・薄型化に対応する次世代プラスチックBGA基板の設備投資を実施することといたしましたので、お知らせいたします。

今後、IoTの進展に伴うビッグデータ活用の拡大や、次世代移動通信規格（5G）への移行による飛躍的なデータ通信量の増加等を背景として、半導体メモリーは高速化・大容量化がさらに進み、市場拡大が見込まれるとともに、小型・薄型化のニーズが一層高まることが想定されます。当社のプラスチックBGA基板は、現在、ハイエンドスマートフォンに搭載される半導体メモリーなどに使用され、需要を拡大しておりますが、これらのニーズに対応することを目的とし、業界に先駆けて最先端のMSAP工法による次世代プラスチックBGA基板の製造ラインを構築することといたしました。



プラスチックBGA基板



最先端技術による微細配線  
(走査電子顕微鏡写真)

### 【設備投資の概要（予定）】

- (1) 設備の内容 : 次世代プラスチックBGA基板製造設備  
一層の小型・薄型化を実現することを目的として最先端のMSAP (Modified Semi Additive Process) 工法の製造ラインを構築いたします。新ラインにより製造するプラスチックBGA基板は、従来製品に比べ、大幅に薄く、また、基板上に形成する配線の飛躍的な微細化をはかることを目指しています。
- (2) 投資額 : 16億円 (2019年度)
- (3) 設置工場 : 新井工場 (新潟県妙高市)
- (4) 稼働開始予定 : 2019年度下期

なお、本件が当社の連結業績に与える影響は軽微であります。

以上